

高速/高密度开放式连接器

技术规格

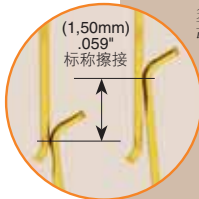
如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?SEAF

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物
触点材料:
铜合金
工作温度范围:
-55°C 至 +125°C
电镀:
在 50μ" (1.27μm) 镍上
镀金或镀锡
触点电阻: 5.5 mΩ
工作电压: 240 VAC
符合 RoHS 规范要求: 是



加工:
最大加工温度:
230°C 下持续 60 秒,
或 260°C 下持续 20 秒, 3 次
可无铅焊接: 是

适配:
SEAM, SADL,
SEAMP,
SEAC
(需要 -LP)



多达 500 引脚

低插入/拔出力

5、8 以及 10 排底面积与 SamArray® 兼容。建议的样品。

无铅焊接端子 (也提供锡/铅)

7mm 堆叠高度	在 -3dB 插入损耗的额定值
单端信号	9.5 GHz / 19 Gbps
差分对信号	10.5 GHz / 21 Gbps
如需完整测试数据, 请浏览 www.samtec.com?SEAF 或联系 sig@samtec.com	

额定电流	
环境温度	SEAM/SEAF
20°C	2.3A
40°C	2A
60°C	1.75A
95°C	1.14A
为 30 个临近位置供电	

行业标准

PISMO 2
VITA 47
VITA 57

支持的协议

Fibre Channel
Rapid I/O
PCI Express®
SATA
Infiniband

登录 www.samtec.com/appnote
下载应用注释
与 SIG @ samtec.com 联系
了解有关协议的问题

SEAF - **每排引脚数** - **引线式样** - **电镀选项** - **排数** - **2** - **A** - **选项** - **K** - **TR**

从图表中指定引线式样

-10, -15, -20, -30, -40, -50
(仅在 04 排提供 -10)
(仅在 10 排提供 -15)

引线式样	A	排数	B
-05.0	(5,05) .199	-04	(5,61) .221
-06.0	(6,05) .238	-05, -06	(8,20) .323
-06.5	(6,55) .258	-08	(10,69) .421
		-10	(13,23) .521

-L
= 10μ" (0,25μm)
触点区域镀金, 焊尾上镀雾锡

-S
= 30μ" (0,76μm)
触点区域镀金, 焊尾上镀雾锡

-04
= 四排

-05
= 五排

-06
= 六排

-08
= 八排

-10
= 十排

-2
= 无铅锡阵列 (需要 -LP)
95.5% 锡/3.8% 银/0.7% 铜焊接

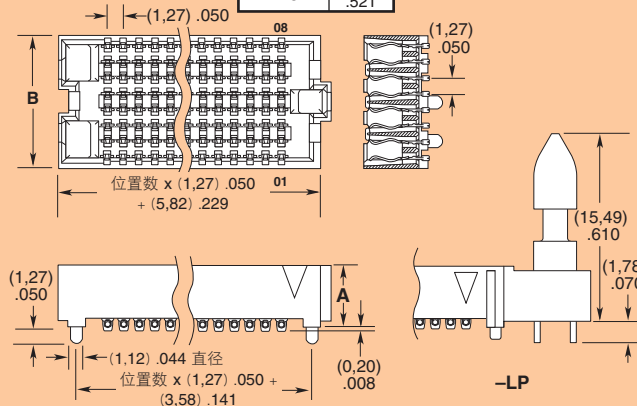
-LP
= 锁紧柱 (需要 -LP)
用于仅与 SEAC 适配)

特殊应用选项

可提供 -07.5 引线式样 30x4 个位置数。请致电 Samtec。

SEAM 引线式样	SEAF 引线式样		
	-05.0	-06.0	-06.5
-02.0	7mm	8mm	8.5mm
-03.0	8mm	9mm	9.5mm
-03.5	8.5mm	9.5mm	10mm
-06.5	11.5mm	12.5mm	13mm
-07.0	12mm	13mm	13.5mm
-09.0	14mm	15mm	15.5mm
-11.0	16mm	17mm	17.5mm

*加工条件将影响适配高度。



差分

阵列	对数*
40x8	80
40x6	60
30x10	75
30x8	60
30x6	45
20x10	50
20x8	40
20x10	25

注: 某些尺寸、式样和选项为非标准型, 不可退换。